

证券代码：300476

证券简称：胜宏科技

胜宏科技（惠州）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-0630-01

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话沟通 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 与姓名	华创证券研究所 岳阳 郭一江 鲍尔太平有限公司 北京成泉资本管理有限公司 北京泓澄投资管理有限公司 博时基金管理有限公司 创金合信管理有限公司 大成基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 歌斐资产 工银瑞信基金管理有限公司 光大保德信基金管理有限公司 光大证券资产管理有限公司 国泰基金管理有限公司 红塔红土基金管理有限公司 红土创新管理有限公司 汇丰晋信基金 嘉实基金管理有限责任公司 建信基金管理有限责任公司 交银施罗德基金管理有限公司 金元顺安基金 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 仁桥（北京）资产管理有限公司

	<p>上海昶元投资管理有限公司</p> <p>上海枫池资产管理有限公司</p> <p>上海磐厚投资管理有限公司</p> <p>上海煜德投资管理中心（有限合伙）</p> <p>韶夏资本</p> <p>申万资管</p> <p>深圳前海瑞园资产管理有限公司</p> <p>深圳市裕晋投资有限公司</p> <p>深圳悟空投资管理有限公司</p> <p>天弘基金管理有限公司</p> <p>五地投资</p> <p>易方达基金管理有限公司</p> <p>长江证券（上海）资产管理有限公司</p> <p>长盛基金管理有限公司</p> <p>招商基金管理有限公司</p> <p>中国人寿资产管理有限公司</p> <p>中金公司资产管理部</p> <p>中信保诚基金管理有限公司</p> <p>中银基金管理有限公司</p> <p>中再资产管理股份有限公司</p>
时间	2021年6月30日 下午 16:00-17:00
地点	电话会议
上市公司 接待人员姓名	<p>董事会秘书：赵启祥</p> <p>财务总监：朱国强</p> <p>投资者关系经理：朱溪瑶</p>

投资者关系活动
主要内容介绍

投资者互动，主要问答内容

Q1: 上游原材料涨价对公司业务有何影响？

答: 二季度原材料涨价的影响在可控范围内。原材料涨价是长期的大趋势，整个行业都在积极应对。公司一直在向客户进行传导，比如和客户协商订单价格的频率明显变高，客户对涨价的接受程度也较好。

Q2: 哪些下游领域的业务增长较快？

答: 上半年增速较快的业务主要有车载、显示、服务器、显卡和消费业务，其中车载和显示类业务增速最快。业务实现高增长主要得益于公司前期优质客户和高端产品的布局，公司未来将继续享受客户结构升级、产品结构升级的红利。

Q3: 全球半导体芯片供应紧张，对公司业务有何影响？是否有汽车厂商因为无芯片可用而停减产或拉货速度放缓？

答: 公司客户中不存在因芯片短缺而停产的情形，公司目前没有看到芯片供应紧张带来的不利影响。

Q4: 订单能见度如何？

答: 目前订单能见度较以往更长，大约在三到四个月。主要因为下游需求旺盛且原材料供应比较紧张导致订单交期变长，因此客户也更倾向于采用更均匀的下单节奏提前下单。

Q5: 公司如何应对汇率波动？

答: 2021 年公司匹配了一部分美元债务，另外签订了远期外汇协议，预计汇率波动对 2021 年业绩影响程度将有所下降。

Q6: HDI 业务的进展情况如何？

答: HDI 是顺应下游需求发展趋势的产品，未来前景广阔，公司从多层板到 HDI 的跨界相对是比较成功的。HDI 板事业部一期于 2019 年下半年投产，产品线不断往高端产品升级，现二阶以上产品占比已超过 60%，其中三阶及以上产品占比超过 7%。HDI 二期已完成装机和调机，正处于小批量试生产阶段，由于地方限电，整体进度比原计划稍晚，预计七月份开始进行产能爬坡。

相较于台厂而言，公司是 HDI 领域的新玩家，前期的客户积累、产品技术积累都需要时间，但公司的设备配置、技术人员水平都是远超目前产品标准的，在未来还有较大的提升空间。

	<p>Q7: IC 载板的未来规划?</p> <p>答: 公司从 2019 年开始布局 IC 封装基板, 引入行业内资深的技术人才, 并建立专项研发团队。目前惠州园区已在进行小批量生产, 另外, 公司计划在海门园区建设 IC 载板一期, 目标产值约 10 亿元。</p> <p>Q8: 定增进展如何?</p> <p>答: 计划近期向深交所提交资料, 具体进度以公司公告为准, 公司会按照相关规定及时履行信披义务。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 20 亿元, 拟将 15 亿元用于海门园区高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目, 5 亿元补充流动资金和偿还银行贷款。</p> <p>Q9: 公司对今年全年的业绩展望如何? 对未来 2-3 年增长是如何规划的?</p> <p>答: 公司今年的目标是实现 30% 以上的增长。中长期的规划方面, 2022 年公司以百亿产值为目标, 根据现有的人才储备、技术储备、客户储备和产能规划, 公司非常有信心达成百亿产值。未来五年, 公司希望继续保持 30% 以上的年化增长, 目前正在筹备的海门园区预计在 2022 年底或 2023 年投入产出, 将为企业未来持续保持快速增长提供产能支持。海门园区全面达产后的目标产值是 200 亿元。</p>
附件清单 (如有)	无